


# 承認書 SPECIFICATION FOR APPROVAL



\ 型號&料號 產品名稱&概述 \	碩方型號 SOFNG PART NO.	客戶料號 CUSTOMER PART NO.	產品分類 SPECIFICATION
	SNO-019		NANO SIM 卡座/SMT 物料 /PUSH-PUSH
產品尺寸	L-16.5mm × W-15.9mm × H-1.5mm/可配卡托		
產品特性	&Push Lever(顶针式)NANO-SIM 卡座/可靠、锡基镀金(鹽霧 24H)、塑膠耐高溫		
客戶名稱			
供應廠商	全稱:東莞市碩方電子科技有限公司&DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD 簡稱:碩方/SOFNG		
產品認證	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RoHS</b> (無鉛)環保產品		<input type="checkbox"/> 其他_____

## SOFNG Factory chapter

碩方發行	檢 查 TESTED BY	審 核 CHECKED BY	承 辦 APPROVAL
	Engineer Chen 陳		PMC Pan 潘
客戶承認	檢 查 TESTED BY	審 核 CHECKED BY	承 辦 APPROVAL

### 注意事項

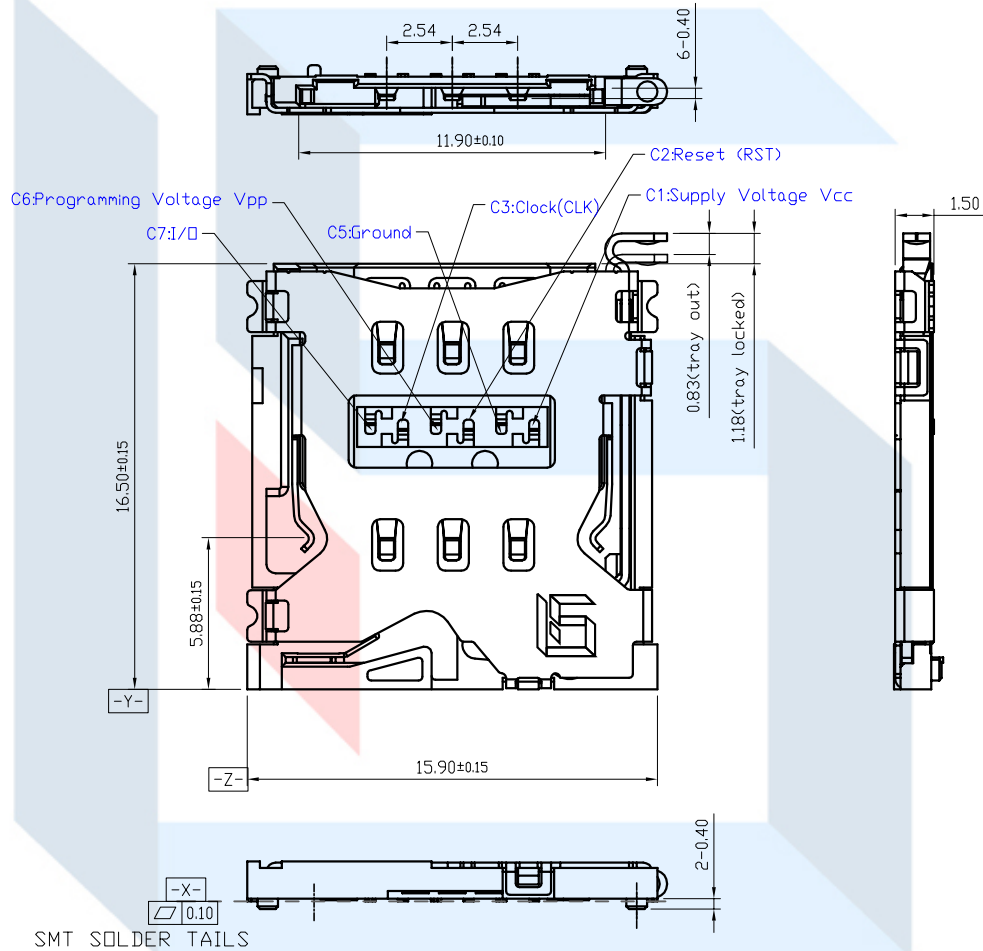
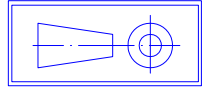
- 1.水溶性助焊劑會使本產品腐蝕的可能,請避免使用;
- 2.給端子進行焊接時,如果在產品上施加壓力,會有移位、變形及電特性劣化可能,請在使用中注意;
- 3.焊兩次錫請在第一次焊接之後恢復到常溫再進行。連續加熱,會使塑膠變形&老化,端子鬆動&脫落及電特性降低的可能;
- 4.避免助焊劑滲入本產品, 會使產品損壞、接觸故障或動作不良;
- 5.印刷電路板&安裝孔位模式,請參照產品圖中記載的推薦尺寸;
- 6.在整機組合安裝工序中,請注意不要對產品施加外力;
- 7.在低電壓條件下 (DC1V 以下) 使用時,會有接觸不良的可能。以直流電阻的負荷設計本產品,不可用於其他負荷 (電感性負荷、電容性負荷) ;
- 8.在使用、測試過程中,如果超過規定以上的操作力,產品有損壞的可能;
- 9.請在常溫常濕[常溫 25°C,濕度在 50°C 以內]、不受陽光照射、不含腐蝕氣體的場所保存,自交貨起 6 個月內為限,請儘快使用。

Operation: Thimble Structure & Push Lever (顶针式) NANO-SIM卡座



LTEM NO.: SNO-019  
(NANO-SIM CARD SOCKETS)

Unit:mm



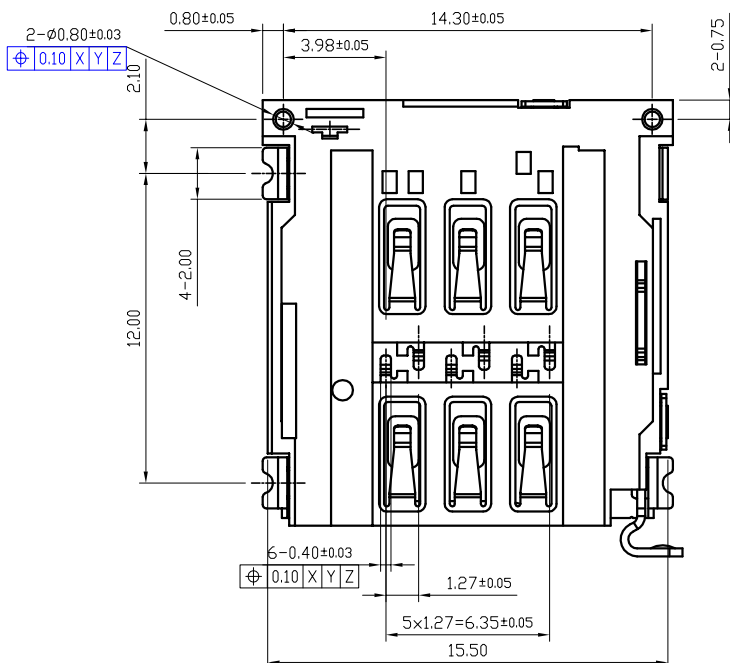
表面貼裝 SMT

側向導入 LATERAL

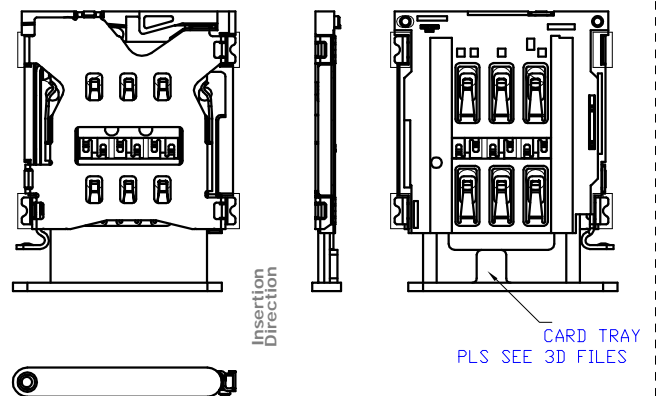
精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

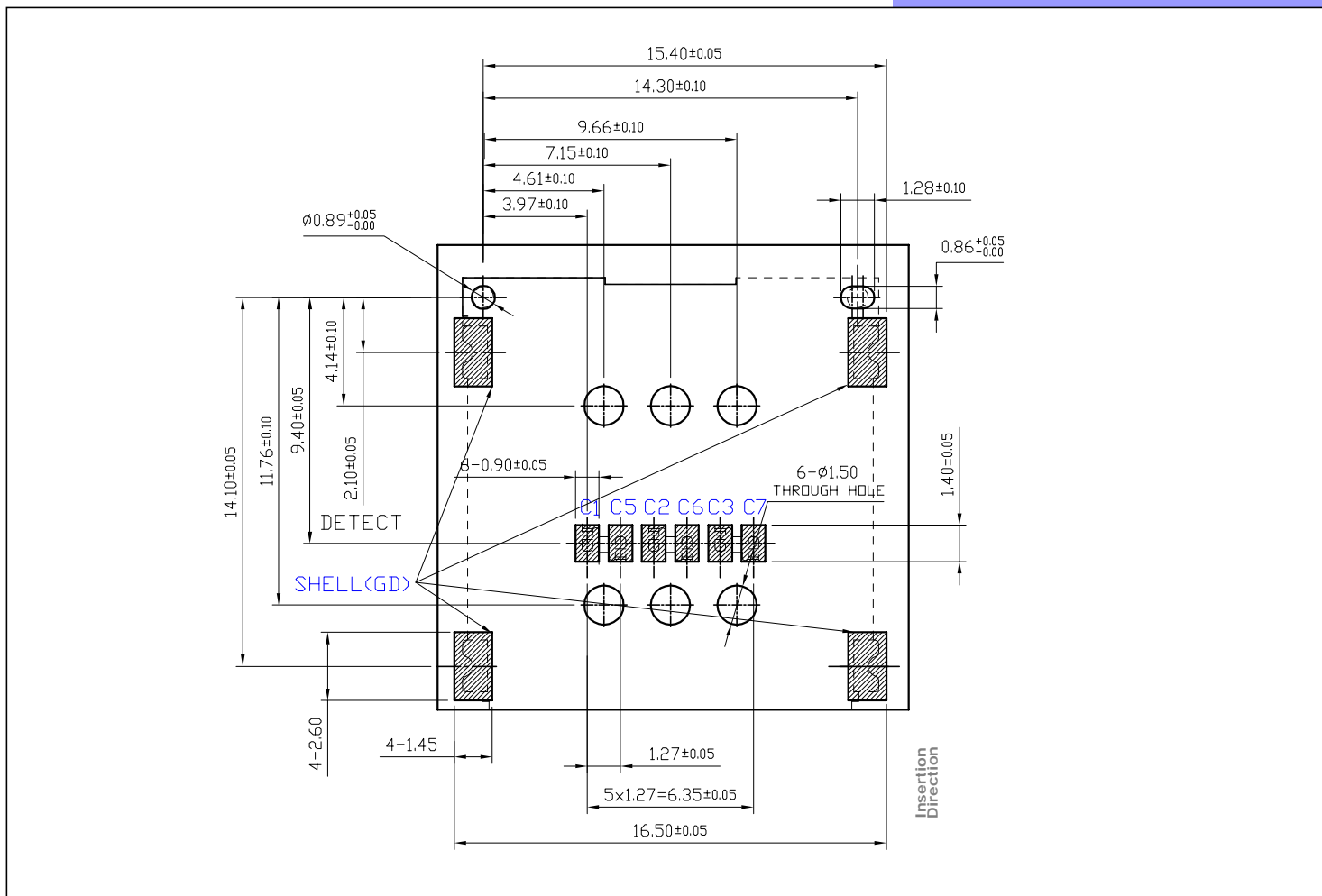
適合環保 RoHS



MATED TRAY DIM.  
(ONLY FOR STANDARD TRAY)



CIRCUIT BOARD SIZE  
(Vertical view)

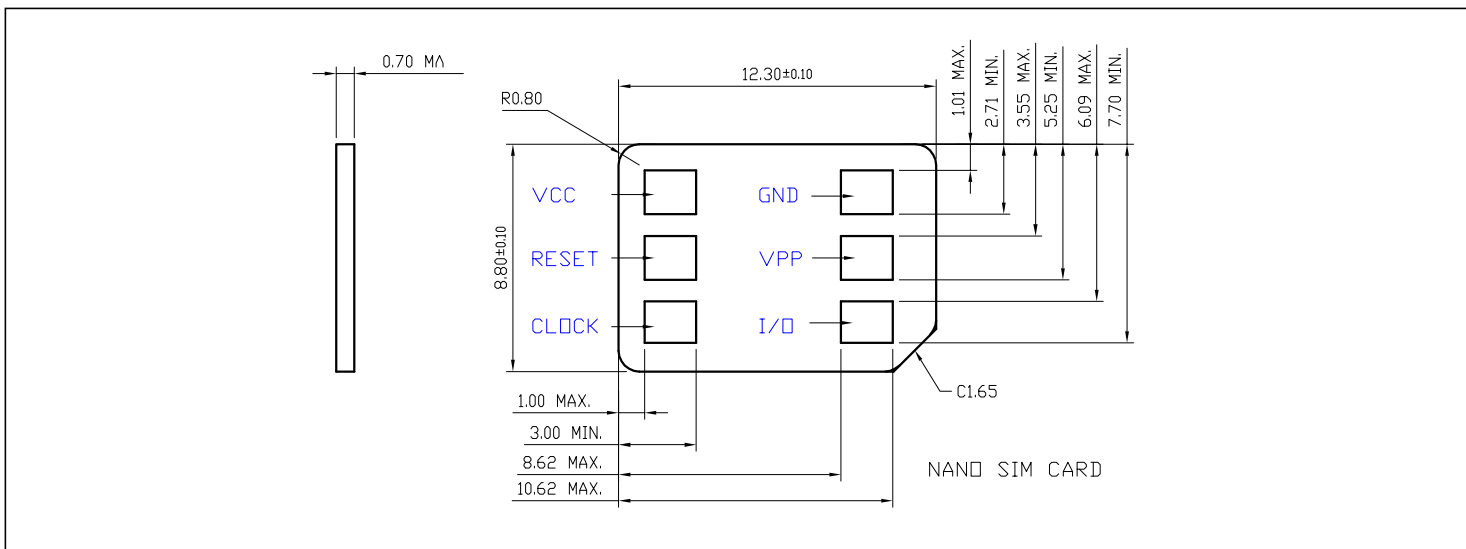


PIN Assignment



SIM CARD Pin DESIGN

Pin No.	Pin NAME	Type	Description
C①	卡電源	1	VCC
C②	復位	1	RST
C③	時鐘	1	CLK
C④	保留項	1	Reserved
C⑤	接地	1	GND
C⑥	Vpp	1	VPP
C⑦	輸入/輸出	1	I/O
C⑧	保留項	1	Reserved

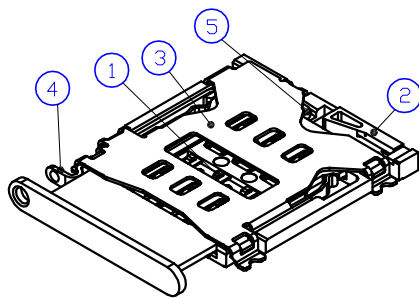


Technical parameter

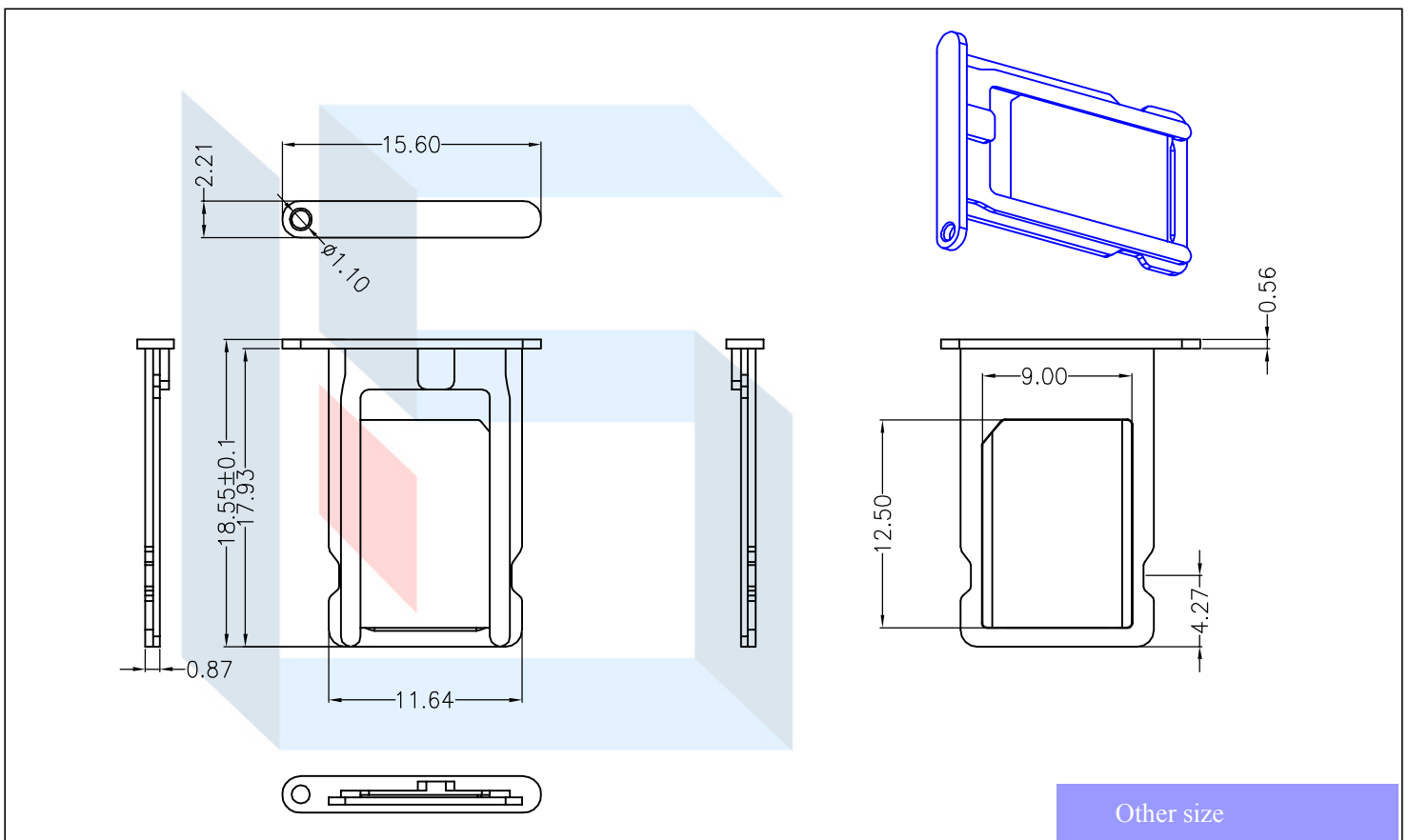
PROJECT		LEVEL	A[better product]	B[average product]	C[low product]
Electrical Properties	Initial Contact Resistance		30mΩ max.	30mΩ max.	no data!
	Contact Resistance		100MΩ min. 100V DC Skey/PD: 50MΩ min. 100V DC		
	Withstand Voltage		300V AC for 1min	250 V AC for 1min	
Durable Performance	There No Load		8,000 Cycles	<b>7,000 Cycles</b>	no data!
	Rated Load		6,500 Cycles 50mΩ max.	<b>5,000 Cycles</b> <b>30mΩ max.</b>	no data!
Insertion Force			4.0Kgf MAX (Springback: )		

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。Products do not belong to hazardous waste,When waste can recycling processing

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常溫 25°C,濕度在 50°C 以內],不可導致材料變形或氧化。



Material declaration			
No.	NAME	MATERIAL	DESCRIPTION
① A	CONTACT	COPPER ALLOY 【G/F】	0.1 μm Ni PLATED OVERALL; BRONZE ALLOY, GOLD PLATING
② B	HOUSING	THERMOPLASTIC	UL 94V-0,COLOR:BLACK;
③ C	SHELL	STAINLESS 【G/F】	SUS304, GOLD PLATING;
④ D	LEVER	STAINLESS 【G/F】	SUS304, NO PLATING;
⑤ E	HINGE	STAINLESS 【G/F】	SUS304, NO PLATING;



Other size

注記 NOTICE

1. 碩方電子公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

## SOFNG-PERFORMANCE REQUIREMENTS

Items	Requirements	Test Methods
1. Temperature rise 温度急变	30° C Max. 不高于30° C	Carry rated current load.0.3A per contact. (UL498) 每根端子负载0.3A 电流。(UL498)
2.Vibration Sinusoidal Low Frequency 低频正弦振动	No electrical discontinuity greater then 1 μ sec (s) shall occur. Contact resistance:100 mΩ max. 不允许出现超过1 μ sec (s) 的瞬间断开, 接触阻抗: 100 mΩ 最大;	Subject mated connector to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.5 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular plane, 10 mA applied MIL-STD-202, Method 201. 对测试样品, 在频率变化每分钟从10-55-10 Hz, 振幅 1.5 mm 条件下, 在互相垂直的三个面上, 每个面2 小时下测量, 电流 10 mA ; 适用: MIL-STD-202 , 方法 201。
3.Shock 冲击	No electrical discontinuity greater than 1 μ sec. shall occur. No damage to product. 不允许出现超过 1 μ sec (s) 的瞬间断开, 产品无损坏;	Applying an appropriate holder is allowed in vibration test and shock test. MIL-STD-202, Method 213,490m/s <sup>2</sup> , 3 axes. 使用合适的固定方式, 适用方法.MIL-STD -202, 方法213, 加速度490m/s <sup>2</sup> , 三个轴上均做测试。
4.Thermal shock 热冲击	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max. 产品无损坏, 接触阻抗: 100 mΩ 最大	Temperature range from -55°C to +85°C .Start from -55°C. After 30 min. change to +85°C, change time is no more than 30 seconds. Total 5 cycles. MIL-STD-202, Method 107D,condition A. 温度变化范围: -55°C~ +85°C ; 从 -55°C 开始, 30 分钟后切换到 +85°C ; 转换时间不超过30 秒; 共5 个循环.适用: MIL-STD-202 , 方法107D , 条件A。
5. Humidity 恒温恒湿	No damage, Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max.. Dielectric Strength should be OK, Insulation Resistance should be 100 MΩ min. 产品无损坏, 接触阻抗: 100 mΩ 最大; 耐电压测试OK, 绝缘阻抗100MΩ 最小;	Temperature :40±2° C 96 hours. Relative humidity: 90-95%; Duration: 96 Hours. MIL-STD-202, Method 103, 温度: 40±2° C 96 小时; 相对湿度: 90-95% ; 时间: 96 小时; MIL-STD-202 , 方法 103。
6. Solderability 可焊性	Appearance of the specimen shall be inspected after the test with the assistance of a magnifier capable of giving a magnification of 10 X for any damage such as pinholes, void or rough surface. 样品在测试完成后, 用放大倍数为30 倍的显微镜, 检查外观损坏如: 小孔, 空焊, 外观粗糙度;	Soldering time: 3 to 5 Seconds Temperature: 255±5°C. 焊接时间: 3~5 秒, 温度: 255±5°C。
7. Resistance to soldering heat 耐焊接热	No damage 产品无损坏	Leave subject product in the 255±5°C chamber for 2 minutes. 产品置于255±5°C 烘箱内2 分钟。
8. Salt Spray 盐雾	Contact Resistance (Low Level) (Final) 100 mΩ max. 接触阻抗(未态) 100 mΩ max.	5±1% salt concentration 24±4 hours 35±2°C MIL-STD-202, Method 101 Condition B. 盐水浓度(重量比) 5±1%, 镀金区域时间24小时, 镀锡区域时间8小时。温度35±2°C; MIL-STD-202, 方法101 , 条件B。
9.High temperature 高温	Contact resistance: 100 mΩ max. 接触阻抗 100 mΩ max.	Subject product to 85±2°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108. 产品置于80 ±2°C 连续96 小时, 适用MIL-STD-202, 方法108。
10.Low temperature 低温	Contact resistance: 100 mΩ max. 接触阻抗 100 mΩ max.	Subject product to -25±5°C for 96 hours continuously. MIL-STD-202, Method 108. 产品置于-25 ±5°C 连续96 小时, 适用MIL-STD-202, 方法108。

## PACKAGE SPECIFICATION 包装规范

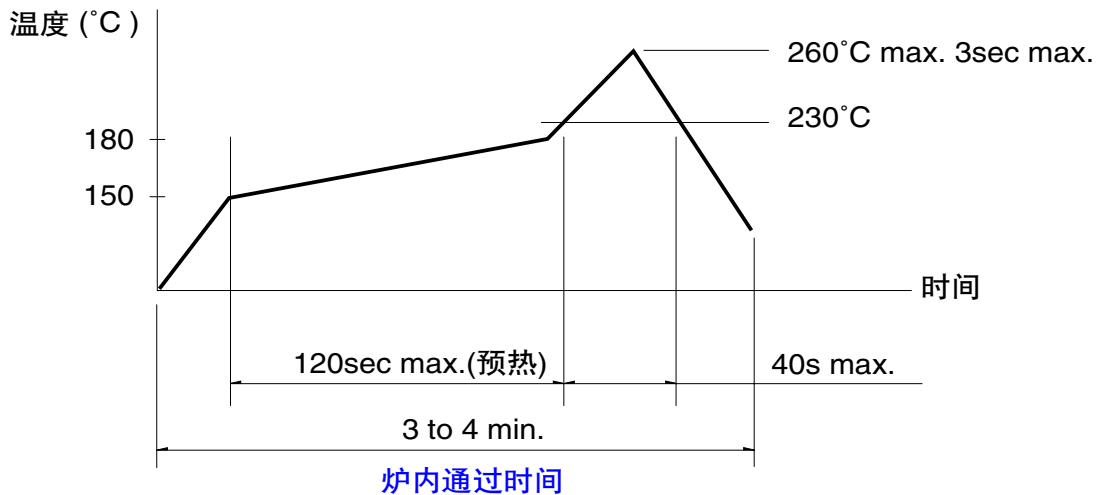
名稱	數量	備註
承载塑料带	1	後端 16cm 预留空料带 最小包装数量标准 前端 23CM 预留空料带。
热封胶带	1	F=可撕/拉开力量 25~130gf.
包装圆盘	1 sets	-
产品标签/认证标识	3	1. 单盘包装标识; 2. 检验合格标识; 3. 环保标识.
包装纸箱	依实际需要	若出货数量低于单品封箱数(通常为 5.0K) 空隙需进行填充.
厚纸板/抗震板	依实际需要	上、下各使用一片
防潮塑胶袋	3	1. 热封平口袋; 2. 防静电真空袋; 3. 热收缩袋。
干燥剂	2	使用于单品包装袋内.
纸制三角柱/抗压柱	4	使用于纸箱内四角.
封箱胶带	依实际需要	使用 SOFNG LOGO 胶带于纸箱开口工字型封合.
外箱标签	2	贴于纸箱相邻两面之右上角.

项目	条件
焊接温度	350°C max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

■ 回流焊

[适用表面贴装型产品]

1. 加热方式：以远红外线上下加热方式。
2. 温度测量：用Φ0.1~0.2的CA (K) 或CC (T) 测量位置在焊接连接部（锡/铜箔面）。
3. 固定方式：采用耐热胶带。
4. 温度分布：（图 2.15）

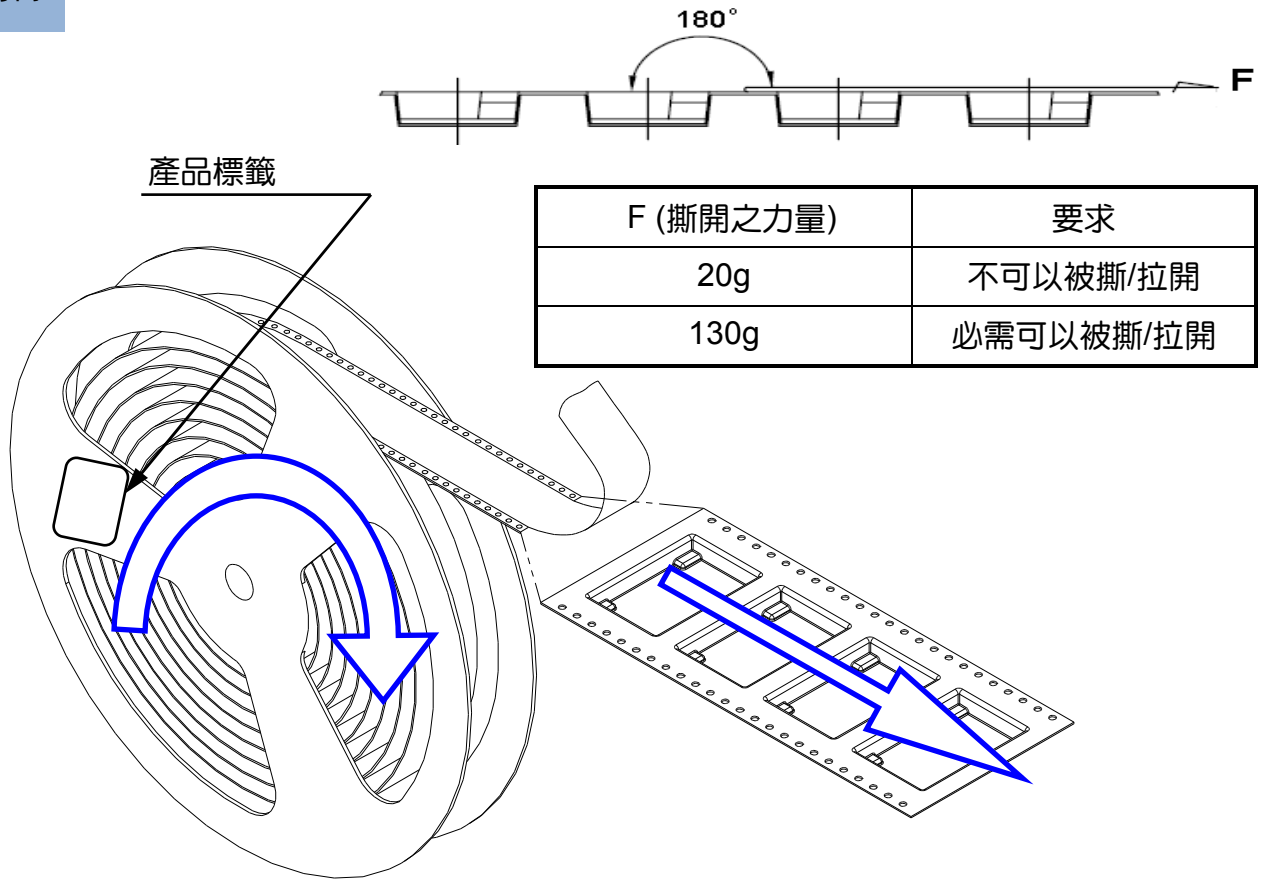


2.15

■ 浸焊式

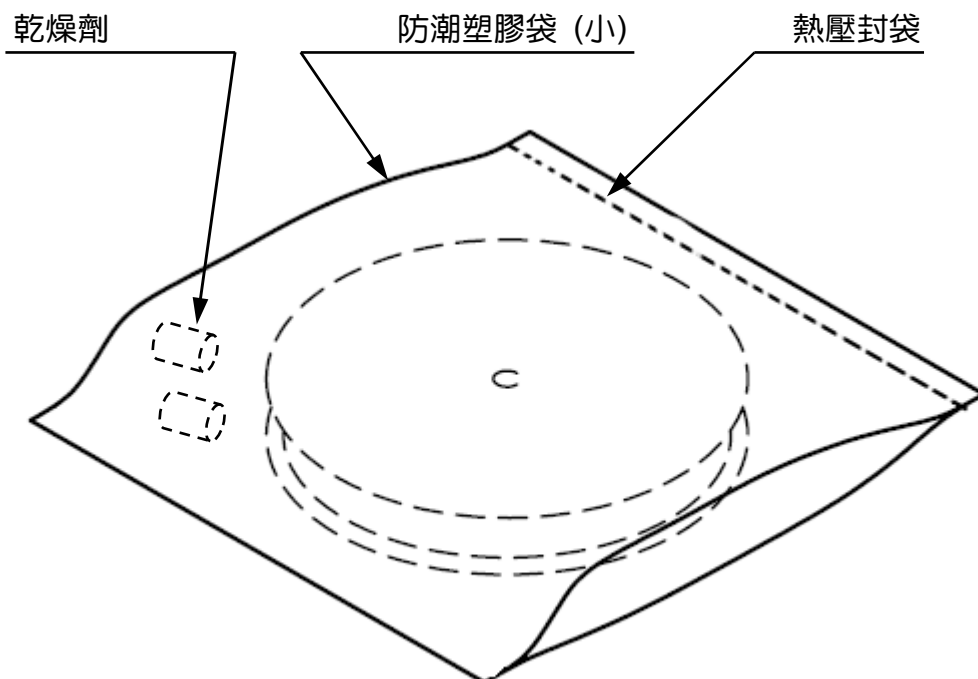
项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100°C max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2次以下

## 1. 载带缠绕方向



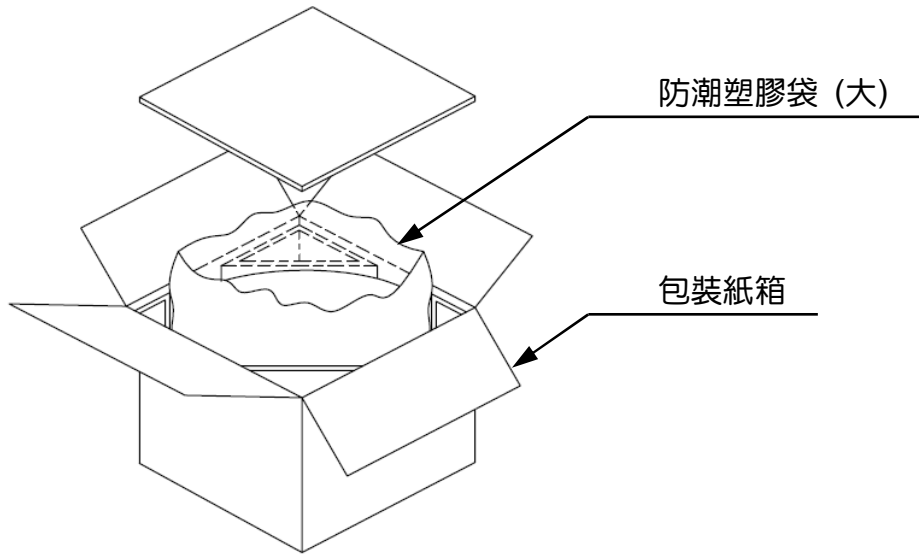
依上述之各項，將產品包入承載料帶內，並封上熱封膠帶，貼上產品標籤。

將完成之料盤放入防潮塑膠袋內，置入兩包乾燥劑，確認無誤後，將塑膠袋口整理平順後，使用熱壓封口機將塑膠袋封口，如下圖所示。



## 2. 单品包装示意图

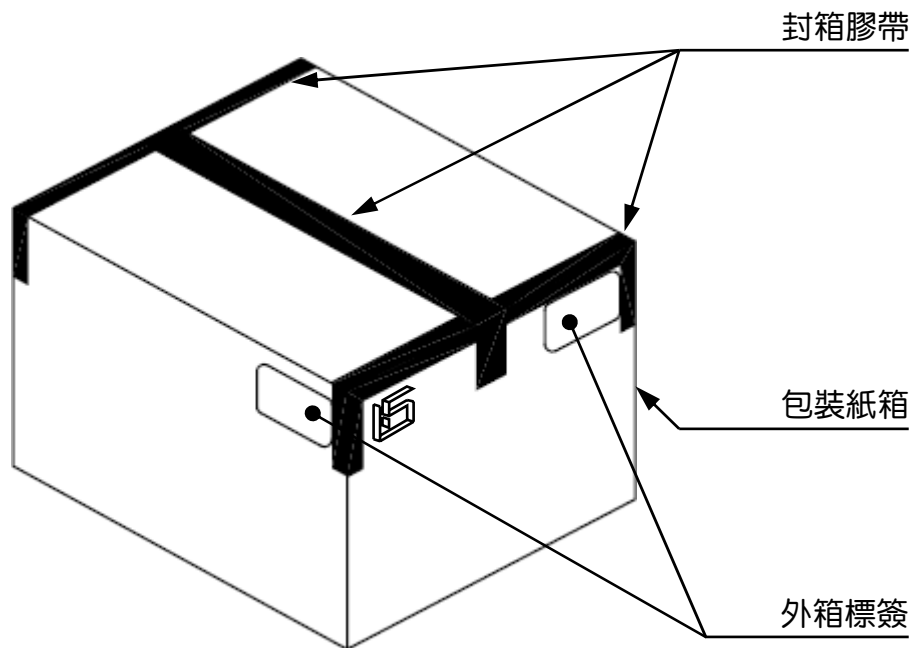
3. 内容及填充示意图



確認置入之捲料盤數量無誤後，將塑膠袋整理平順，加以折疊並塞入紙箱之中，最後再將紙箱封好。如上圖所示。

以封箱膠帶依下圖之位置封好。

貼上出貨標籤。完成之出貨包裝如下圖。



硕方封箱胶带图



4. 外封箱示意图